

第30回マイクロエレクトロニクス研究会プログラム

2018年11月10日

会場:TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 ホール 8A

【基調講演】

13:00～13:45 「半導体テクノロジーへの期待と展望 :これから 20 年先を見据えて」
東京大学 名誉教授・公益社団法人 応用物理学会 柴田 直

【特別講演】

13:45～14:30 「イメージセンサの更なる進化」
ソニー株式会社 平山 照峰

14:30～14:45 休 憩

14:45～15:15 「3D-stacked CMOS イメージセンサ技術の次世代イメージング応用」
東北大学大学院工学研究科 山下 雄一郎

15:15～15:45 「大規模アレイテスト回路を用いた局所的欠陥起因のゲート絶縁膜信頼性に関する研究」
東北大学大学院工学研究科 朴 賢雨

15:45～16:15 「すばらしい技術がなぜ新事業にならないのか？—総合情報戦のすすめ—」
日経BP社 望月 洋介

16:15～16:30 休 憩

【特別講演】

16:30～17:15 「ビックデータの活用によるメモリ製造革新」
東芝メモリ(株) 赤堀浩史

17:15～18:00 「先進半導体センサ・デバイス開発プロジェクトの展開」
東北大学大学院工学研究科・未来科学技術共同研究センター 須川 成利

The 30th International Microelectronics Conference Program

Nov.10, 2018

Venue: TKP Garden City PREMIUM Sendai West, Hall 8A

[Keynote Speech]

13:00~13:45 “Prospects and Perspectives of Semiconductor Technology toward Twenty Years Ahead”
Professor Emeritus, The University of Tokyo
APEX/JJAP
Tadashi SHIBATA

[Special Speech]

13:45~14:30 “Further Evolution of Image Sensors”
Sony Corporation
Teruo HIRAYAMA

14:30~14:45 Break

14:45~15:15 “3D-Stacked CMOS image sensor technology for advanced imaging”
Graduate School of Engineering, Tohoku University
Yuichiro YAMASHITA

15:15~15:45 “A Study of Gate Insulator Reliability due to Localized Defects Using Large Scale Array Test Circuit”
Graduate School of Engineering, Tohoku University
Hyeonwoo PARK

15:45~16:15 “Why does not a emerging technology become a new business?”
Nikkei Business Publications, Inc.
Yosuke MOCHIZUKI

16:15~16:30 Break

[Special Speech]

16:30~17:15 “Utilization of Big Data for Innovation in Semiconductor Memory Manufacturing”
Toshiba Memory Corporation
Hiroshi AKAHORI

17:15~18:00 “Progress of the Advanced Semiconductor Sensor and Devices Project”
Graduate School of Engineering and New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University
Shigetoshi SUGAWA